

**关键指标**

- 频率: 2.7~3.5GHz
- 功率增益: 20dB
- 输出功率: 47dBm(50W)
- 功率附加效率: 42%
- 工作电压: Vdd: +28V (脉冲), Vg: -2.1V
- 静态电流: 160mA
- 封装形式: 载板式
- 产品尺寸: 8.8mm×8mm×0.7mm

**产品简介**

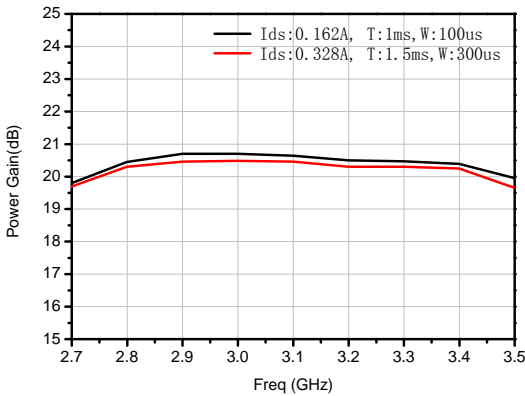
HG532F3 是一款 S 波段小型化内匹配功率放大器，有载板式和管壳封装两种形式，功率增益为 20dB，输出功率为 50W，全频带内功率附加效率为大于 40%。

**电性能** (VD=28V, Vg=-2.1V, Pin=27.5dBm, Ids:160mA ; T:1000us, W:100us, 占空比 10%)

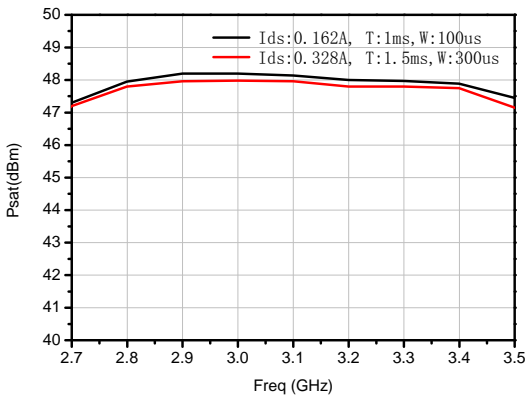
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	2.7~3.5		
功率增益(dB)	—	20	—
增益平坦度(dB)	—	±0.5	—
输出功率(W)	—	50	—
功率附加效率 (%)	—	42	—

**典型测试曲线**

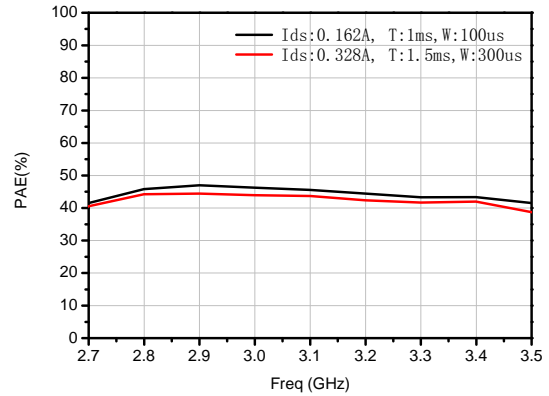
功率增益



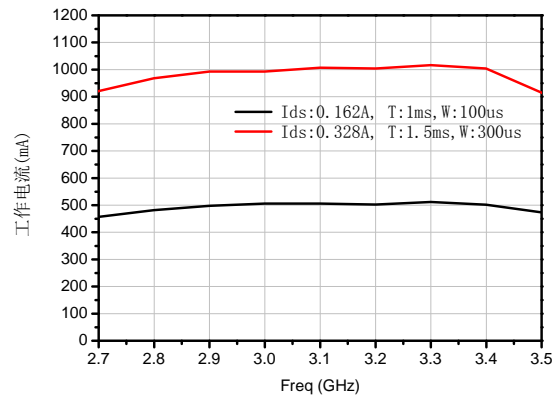
输出功率



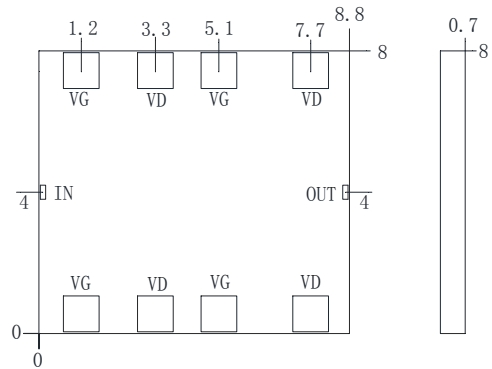
功率效率



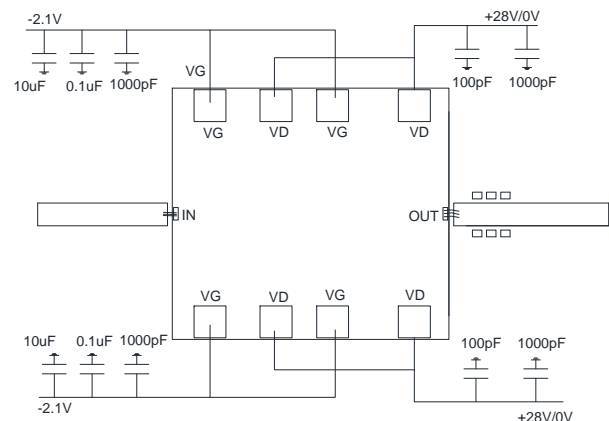
工作电流



**外形和端口尺寸 (mm)**



**推荐装配图**



#### 绝对额定最大值

工作电压	36V
最大输入功率	+30dBm
工作温度	-55°C~85°C
存储温度	-65°C~150°C

#### 注意事项

- 1.器件内部含有单片集成电路，属静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
- 2.产品为载板式功率器件，已采用金锡合金烧结芯片，使用时采用银锡合金进行载板烧结；
- 3.放大器输入、输出端有隔直电容，建议采用 3 根  $\Phi 25\mu\text{m}$  金丝进行端口键合，输出带线压焊点宽度适当增宽；
- 4.加电时请确认接电顺序，先加栅压再加漏压；关电先关漏压，再关栅压。